

应用介绍

特点

一款单组分热固化环氧胶,可低温固化,具有高强度,低CTE,易返修等特点; 并具有良好的耐湿热高可靠性性能; 适用于电子器件的结构性粘接。

粘接材料

金属, 塑料/PCB、LCP, 玻璃等

典型应用

电子元器件结构性粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	黑色	
粘度(cps)	8160	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件*	10min@80°C	
有效期@ -5°C,月	6	

*固化温度是指固化时胶水本身达到的温度.

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	76D	ASTM D-2240
玻璃化温度	30°C	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
CTE (ppm/°C)	α_1 :55 α_2 :120	
降解温度	350°C	
可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	
工作温度范围	-55°C—150°C	

储存和使用方法

产品需低于-5°C环境中保存,使用前请先移至室温解冻, 30ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触,对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件;

注:

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺,对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

